

Ms 32 k  
SMD – RFID Transponderspule

Ms 32 k  
SMD – RFID transponder coil

**Kennzeichen**

- Großer Induktivitätsbereich
- Geringe Höhe
- Automatisch bestückbar
- Für Reflow- und Dampfphasenlötung
- Ansaugfläche (ASF) oder Halbverguss
- **Verklebung mit PCB durch HSF (optional)**
- AEC-Q200 qualifiziert

**Features**

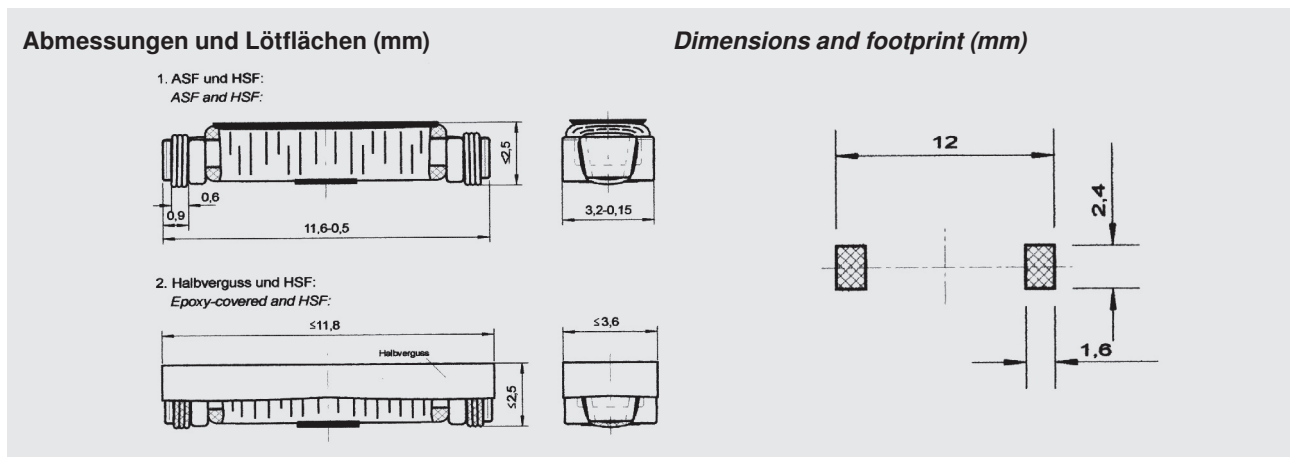
- Wide inductance range
- Low height
- Suitable for automatic insertion
- For reflow and vapor phase soldering
- Pick and place area or epoxy-covered
- **Glueing with PCB by HSF (hot melting dot) (optional)**
- Qualified to AEC-Q200

**Anwendungen**

Transponder-Antennen, Entkopplung in HF- und ZF-Schaltungen, Einsatz in selektiven Kreisen

**Applications**

Transponder antennas, decoupling in RF- and IF-circuits, use in frequency selective circuits



**Induktivitätsbereich:**

10 µH - 39 mH

**Empfohlene**

**Löttechnik:**

Reflow

**Max. Löttemperatur:**

260°C, 10 Sek.

**Betriebs-  
temperaturbereich:**

-40°C bis +125°C

**Verpackung:**

siehe Verpackungs-  
vorschrift,  
Blisterpack DIN EN  
60286/3

**Verpackungseinheit  
(Stück/ Rolle):**

3000

**Inductance range:**

10 µH - 26 mH

**Recommended  
soldering method:**

Reflow

**Soldering heat**

**resistance:**

260°C / 10 sec.

**Operating  
temperature range:**

-40°C to +125°C

**Packaging:**

see tape and reel  
specifications,  
Blisterpack DIN EN  
60286/3

**Packaging unit  
(parts/reel):**

3000

**Vorläufige Daten | Preliminary data**

L	Q ≥	f <sub>L,Q</sub>	f <sub>res</sub> ≤	R <sub>DC</sub> ≤	I <sub>max</sub>	s	Art.-Nr.
[mH]		[kHz]	[MHz]	[Ω]	[mA]	[mV/A/m]	part number
26	4	21,8	0,23	153	15	10 *1	00 6172 80
26	4	5,5	0,23	153	15	-	00 6172 80

µH		[MHz]	[MHz]	[mΩ]			
6,82		13,56	50	150	-	-	00 6172 90

Gluing with PCB by HSF optional

S-measurement with Helmholtz coil at \*) 125 kHz \*1) 21,8 kHz